



深圳成光兴光电技术股份有限公司

SHENZHEN CGX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, INC..

# 樣品規格承認書

## SAMPLE APPROVAL SHEET

客戶名稱

Company Name : \_\_\_\_\_

產品型號

Part Number: CGX-3535IRPC/D28-S

送樣日期

Sample Date: \_\_\_\_\_

APPROVED SIGNATURES (供應商確認)		
核准	品保	工程

客戶確認：樣品承認通過 不予承認需重新送樣 不予承認不用送樣

客戶建議: \_\_\_\_\_

APPROVED SIGNATURES (客戶確認)		
核准	工程	品保

請貴司確認回傳，謝謝！

Add：深圳市龙华新区观澜章阁村宝观科技园 B 栋

TEL: 86-755-66631006 FAX: 86-755-61899639

E-mail:szcgx@szcgx.com Http:www.szcgx.com



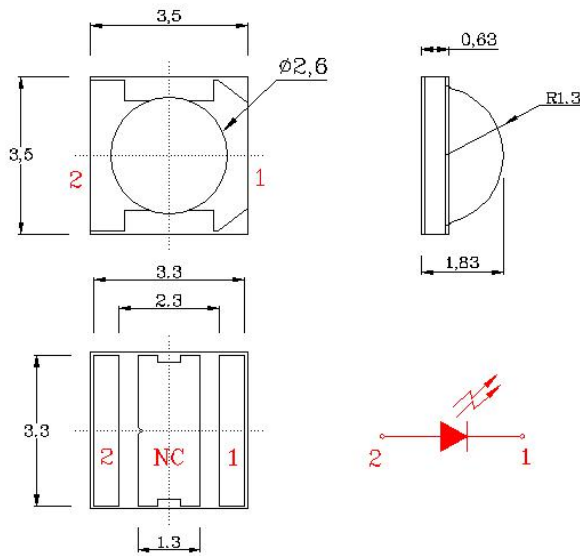
## 产品特性:

- ◆ 小尺寸，高功率
- ◆ 陶瓷基板技术封装
- ◆ 低热阻，长寿命
- ◆ 符合 RoHS 要求
- ◆ 可回流焊

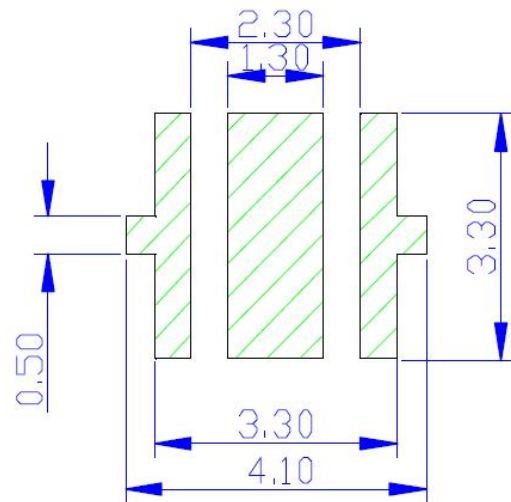


## 产品尺寸图:

产品尺寸图



建议焊盘图



备注：公差 .X:  $\pm 0.1\text{mm}$  .XX:  $\pm 0.05\text{mm}$

产品型号	芯片材质	发光颜色
CGX-3535IRPC/D28-S	AlGaAs	Infrared



# 深圳成光兴光电技术股份有限公司

SHENZHEN CGX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, INC..

## 产品参数

### 最大参数值 Ta=25℃

参数	标示	最大值	单位
功率	PD	1500	mW
正向脉冲电流	IFP	1500	mA
正向电流	IF	700	mA
结点温度	Tj	115	℃
工作温度	Topr	-40℃ to +85℃	
储存温度	Tstg	-40℃ to +100℃	
焊接温度	Tsld	回流焊焊接: 225℃/10 秒	

备注：正向脉冲电流条件：脉宽≤10 毫秒 周期≤1/10

### 技术参数值 Ta=25℃

参数	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
辐射功率	Po	280	500	----	mw	IF=700mA
发光角度	2 θ 1/2	----	120	----	Deg	
峰值波长	λ p	840	855	865	nm	IF=700mA
半波宽	Δ λ	----	40	----	nm	IF=700mA
正向电压	VF	1.4	1.6	----	V	IF=350mA
		1.6	1.8	2.2	V	IF=700mA
反向电流	IR	----	----	10	μ A	VR=5V

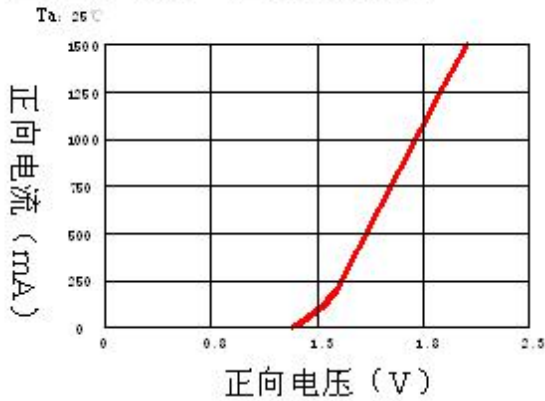


# 深圳成光兴光电技术股份有限公司

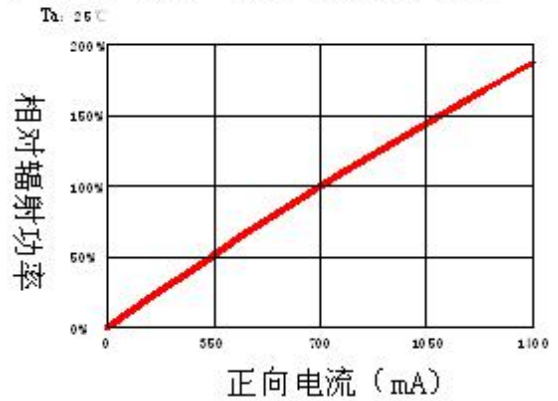
SHENZHEN CGX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, INC..

## 产品典型特性曲线:

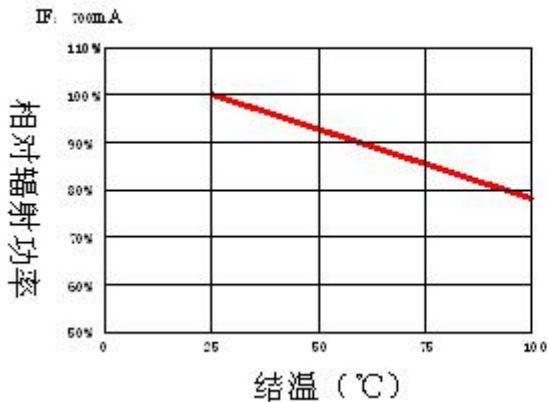
■ 正向电压VS正向电流曲线



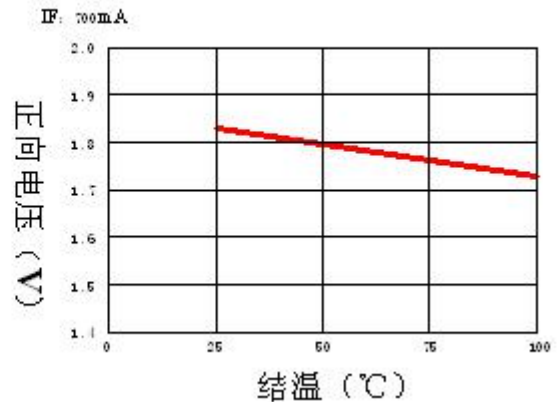
■ 正向电流VS相对辐射功率曲线



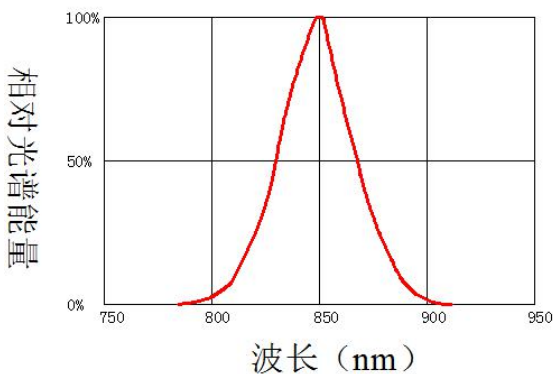
■ 结温VS相对辐射功率曲线



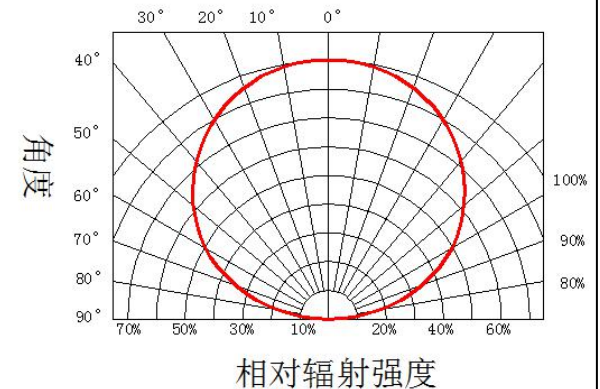
■ 结温VS正向电压曲线



■ 波长VS相对光谱能量曲线



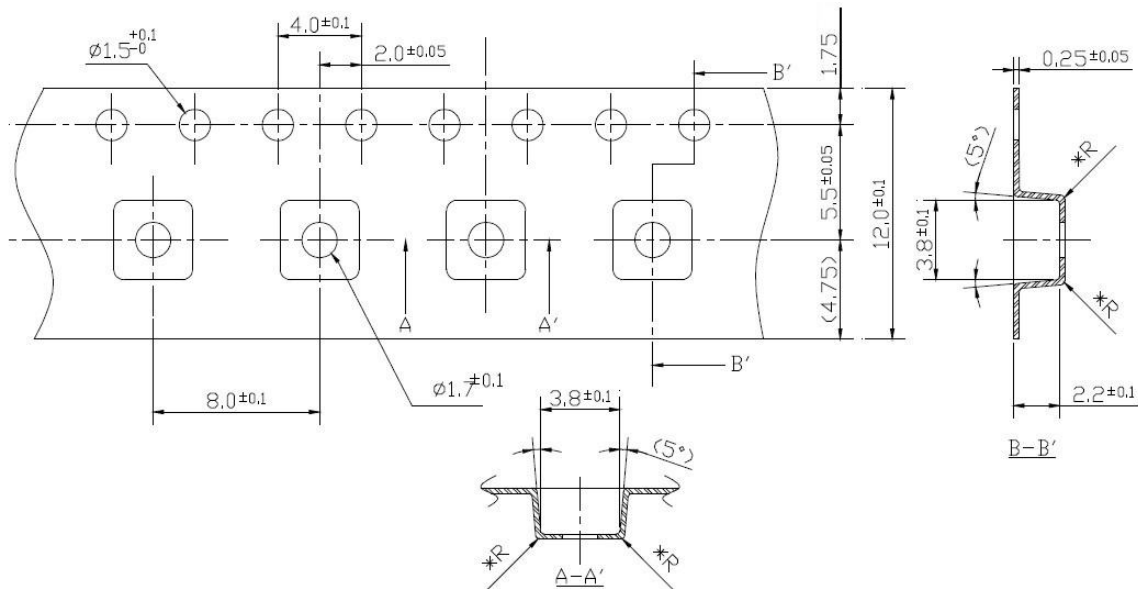
■ 相对辐射强度VS角度曲线



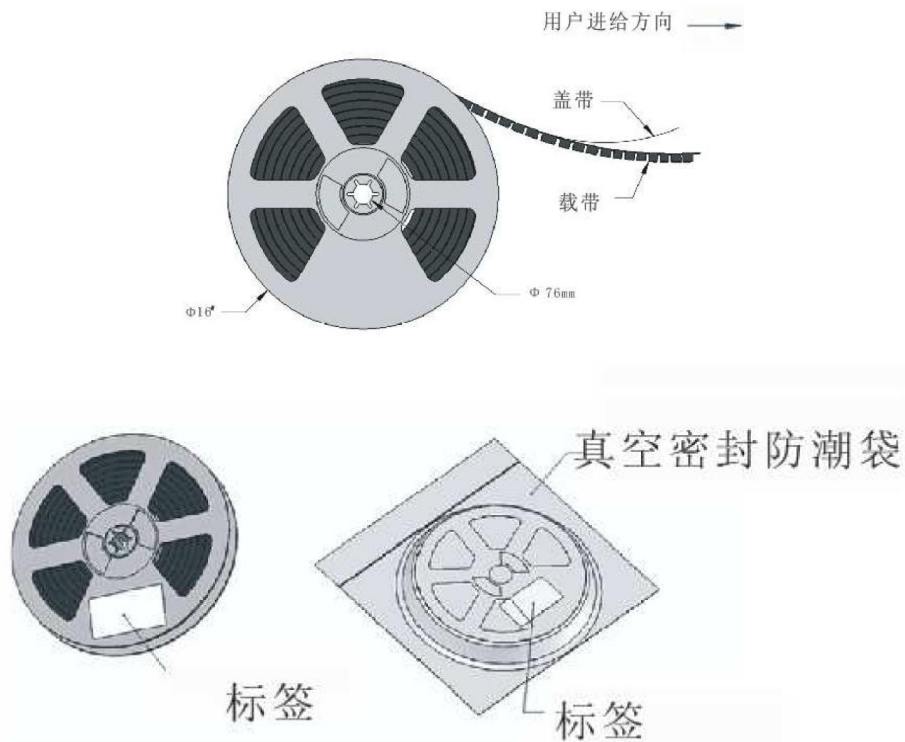


## 产品包装

### 3535 陶瓷系列产品载带尺寸



### 3535 陶瓷系列产品包装



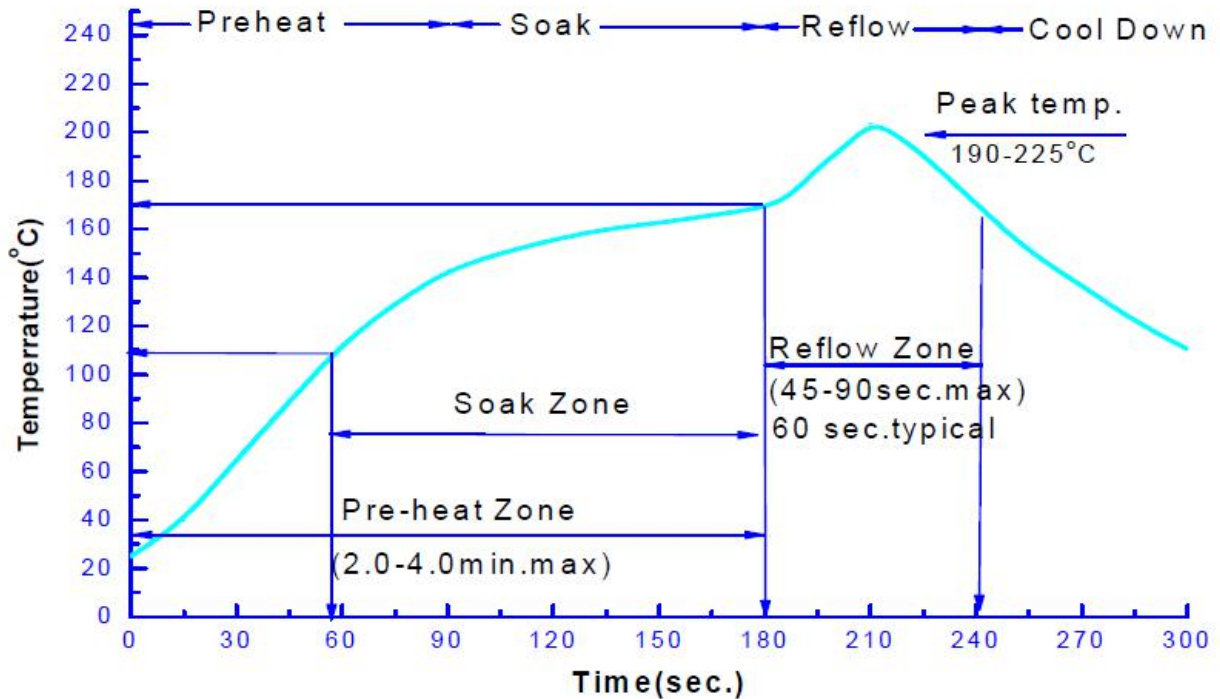


# 深圳成光兴光电技术股份有限公司

SHENZHEN CGX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, INC..

## 产品焊接

产品焊接推荐回流焊接曲线



温度曲线特点	参考设置
平均升温速度(Tsmax至Tp)	最高3°C/秒
预热: 最低温度	(T <sub>smin</sub> )
预热: 最高温度(Tsmax)	150°C
预热: 时间(tsmin至tsmax)	60-120秒
维持高于温度的时间: 温度(TL)	183°C
维持高于温度的时间: 时间(TL)	60-150秒
峰值温度(Tp)	225°C
在实际峰值温度(tp)5°C内的时间	10-30秒
降温速度	最高6°C/秒
25°C升至峰值温度所需时间	最多6分钟

注意: 建议采用回流焊机进行焊接, 不可采用烙铁进行焊接。





## 产品储存:

1. 未打开原始包装的情况下, 建议储存的环境为: 温度: 5°C-30°C, 湿度: 85%以下。
2. 打开原始包装后, 建议储存环境为: 温度: 5°C-30°C, 湿度: 60%以下。
3. LED是湿度敏感器件, 为避免原件吸湿, 建议打开包装后, 将其储存在有干燥剂的密闭容器内, 或者储存在氮气防潮柜内。
4. 打开包装后, 原件应该在12小时内使用。
5. 如果干燥剂失效或者器件暴露空气中超过 12 小时, 应作除湿处理: 条件: 60°C/24H。

## 产品烘烤除湿:

1. 焊接前LED使用说明: 如果在打开包装之后, 但在焊接之前, 大功率 LED 暴露于潮湿的环境中, 则在焊接过程中, LED 可能会发生损坏。
2. 储存方式的说明: 暴露时间超出下面规定时间的LED 必须依照下面所列的烘焙条件进行烘焙。下面的降级表确定了LED 可以暴露在所列的湿度和温度条件下的最长时间 (以天为单位)。

温度	最大相对湿度 (百分比)						
	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
30°C	9	5	4	3	1	1	1
25°C	12	7	5	4	2	1	1
20°C	17	9	7	6	2	2	1

- 3 烘焙条件: 没有必要烘焙所有 LED。只有满足下列标准的 才必须烘焙:
  1. 已经从原始包装取出的LED
  2. 暴露于潮湿环境的时间超过上面“湿气敏感度”部分所列时间的 LED
  3. 尚未焊接的 LED
  4. 在烘烤后一个小时内对部件进行回流焊, 或者立即将部件储存在相对湿度小于20%的容器内。

LED 应在 60°C 下烘焙 24 小时。LED 可以在其原始卷盘上进行烘焙。在烘焙之前, 将 LED 从包装中取出。请勿在高于 60°C 的温度下烘焙部件。经过此烘焙处理后的 LED 的暴露时间重新按照上面的“湿气敏感度”部分确定。

正确的烘焙



错误的烘焙

